

特点:

- -3dB 带宽: $\geq 80\text{MHz}$
- 带外抑制: $@1770\text{MHz} \geq 70\text{dB}$
- 带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: $20.5 \times 9.5 (\text{max}) \times 5.4\text{mm}^3$
- 工作温度: $-55 \sim +85^\circ\text{C}$
- 产品执行标准为 SJ20764-1999

图片:



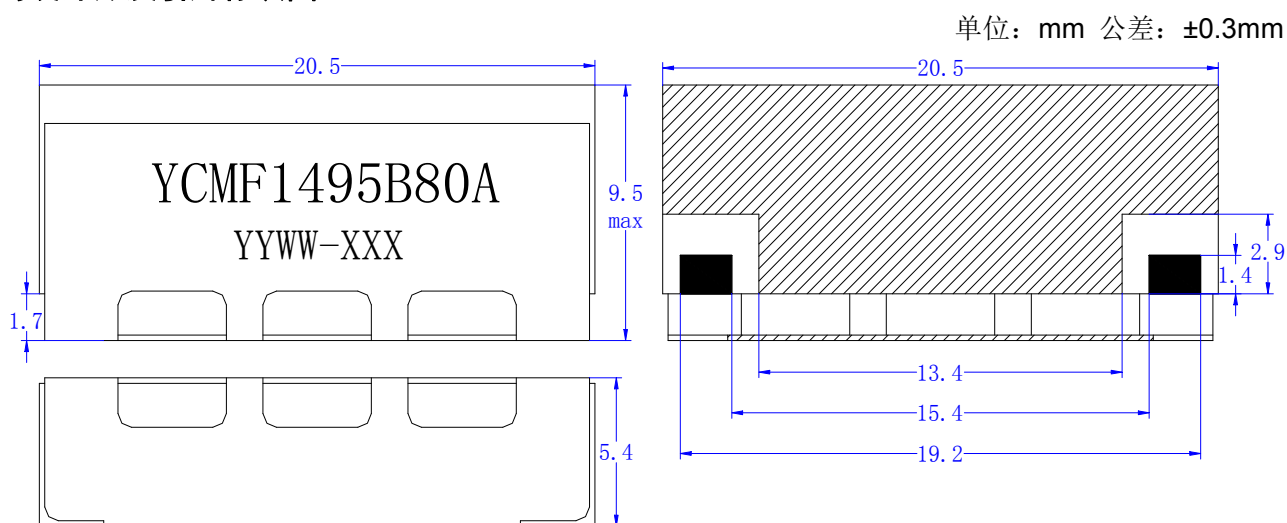
性能参数: ($T_A=25^\circ\text{C}$, 50Ω 系统)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	f_0		1495 $\pm$ 10			MHz	
-3dB 带宽	$BW_{-3\text{dB}}$		80			MHz	
插入损耗	IL	$P_{\text{IN}}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=1495\text{MHz}$		2.0	2.3	dB	
输入带内驻波比	VSWR _i	$P_{\text{IN}}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=1465 \sim 1525\text{MHz}$		1.5:1	2.0:1		
输出带内驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		
阻带抑制	SR ₁	$P_{\text{IN}}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=1 \sim 1250\text{MHz}$	50			dB	
	SR ₂	$P_{\text{IN}}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=1650 \sim 2100\text{MHz}$	50			dB	
	SR ₃	$P_{\text{IN}}=0\text{dBm}$ $f_{\text{TEST}}=1700\text{MHz}$	70			dB	
质量	m				10.0	g	

极限参数表:

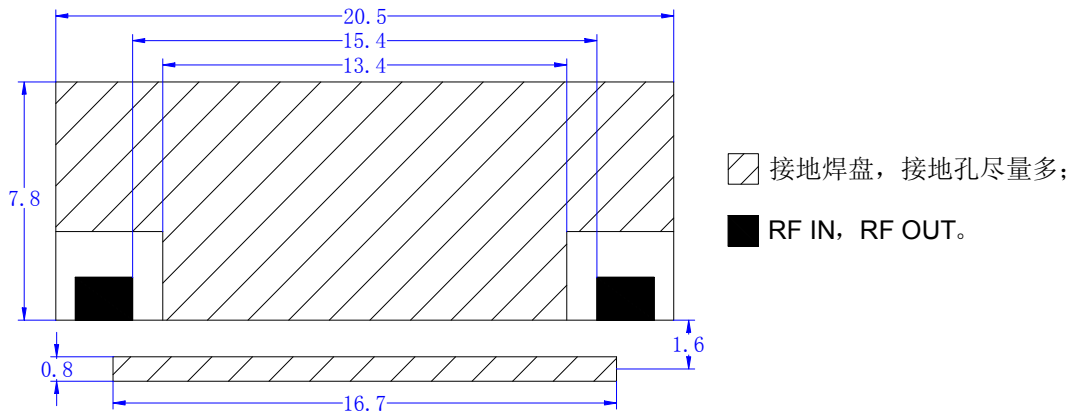
参数名称	极限值	单位
贮存温度	$-55 \sim +100$	$^\circ\text{C}$
输入射频功率	30.0	dBm

封装外形及引脚标识图:



表面处理: 陶瓷介质镀银, 屏蔽罩镀镍。

推荐焊盘图：



字符标志：

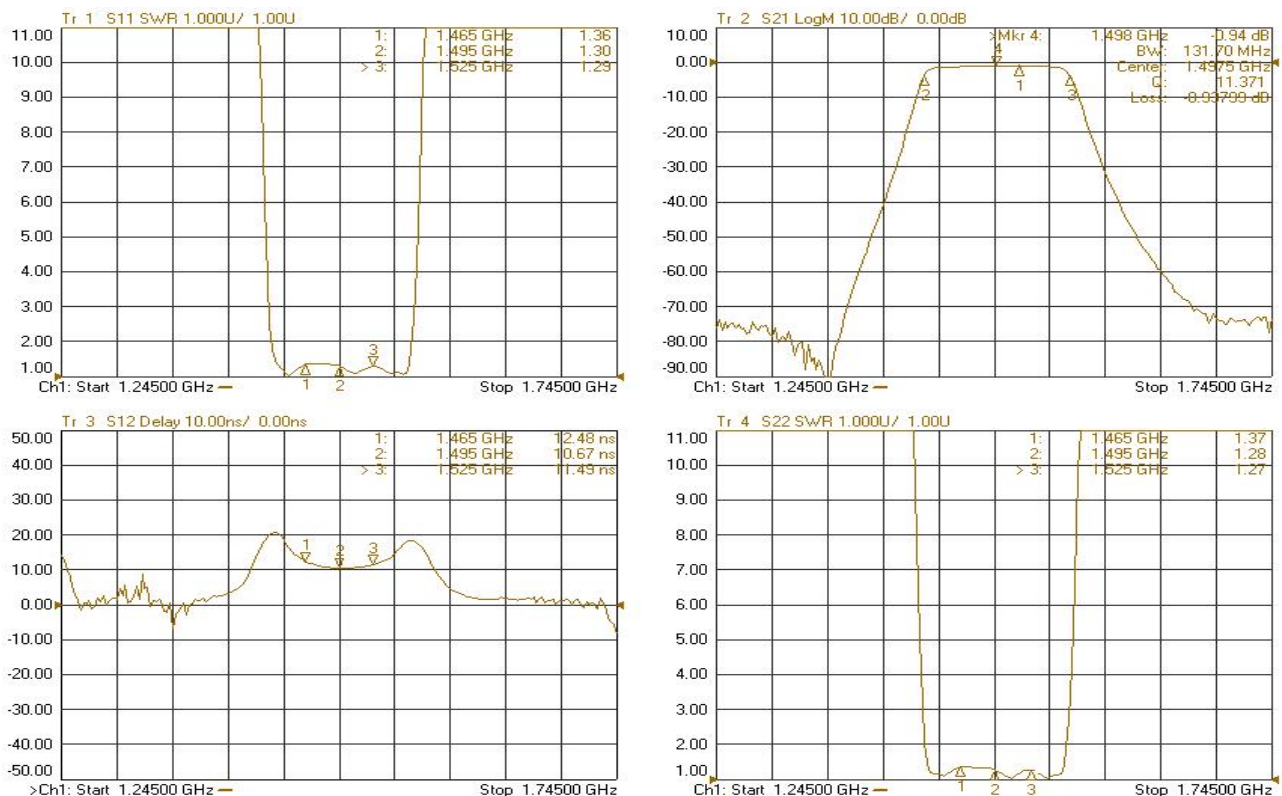
YCMF1495B80A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义：

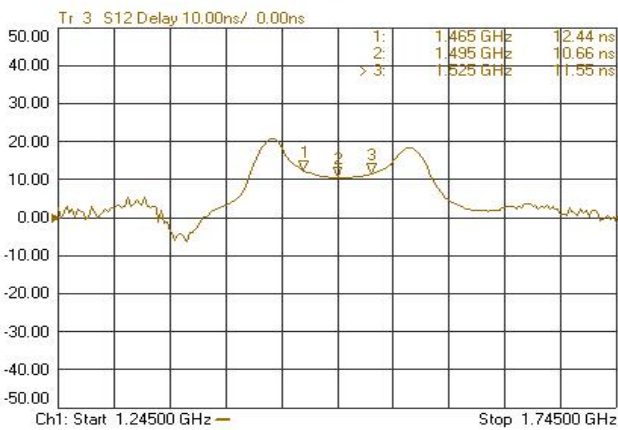
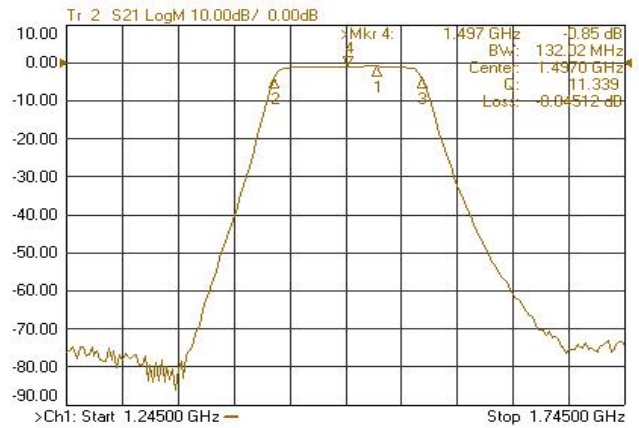
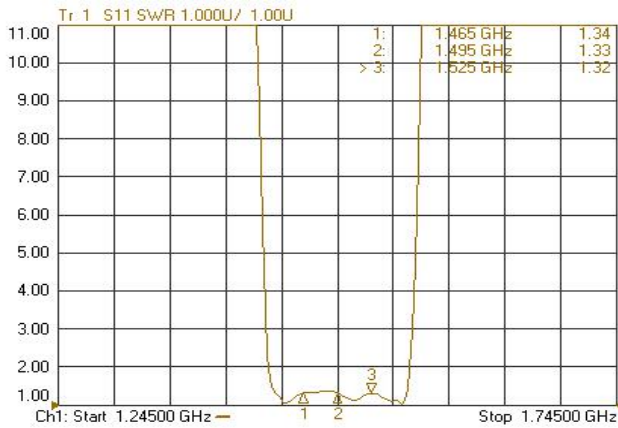
接口标识	接口说明
■	RF IN, RF OUT (可互换)
▨	GND

测试曲线：

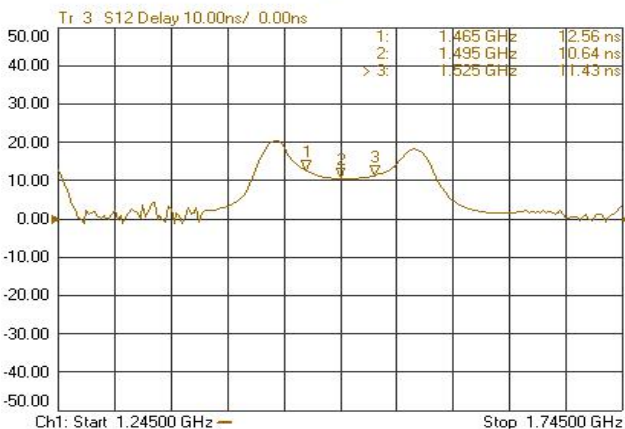
+25℃带内指标典型曲线



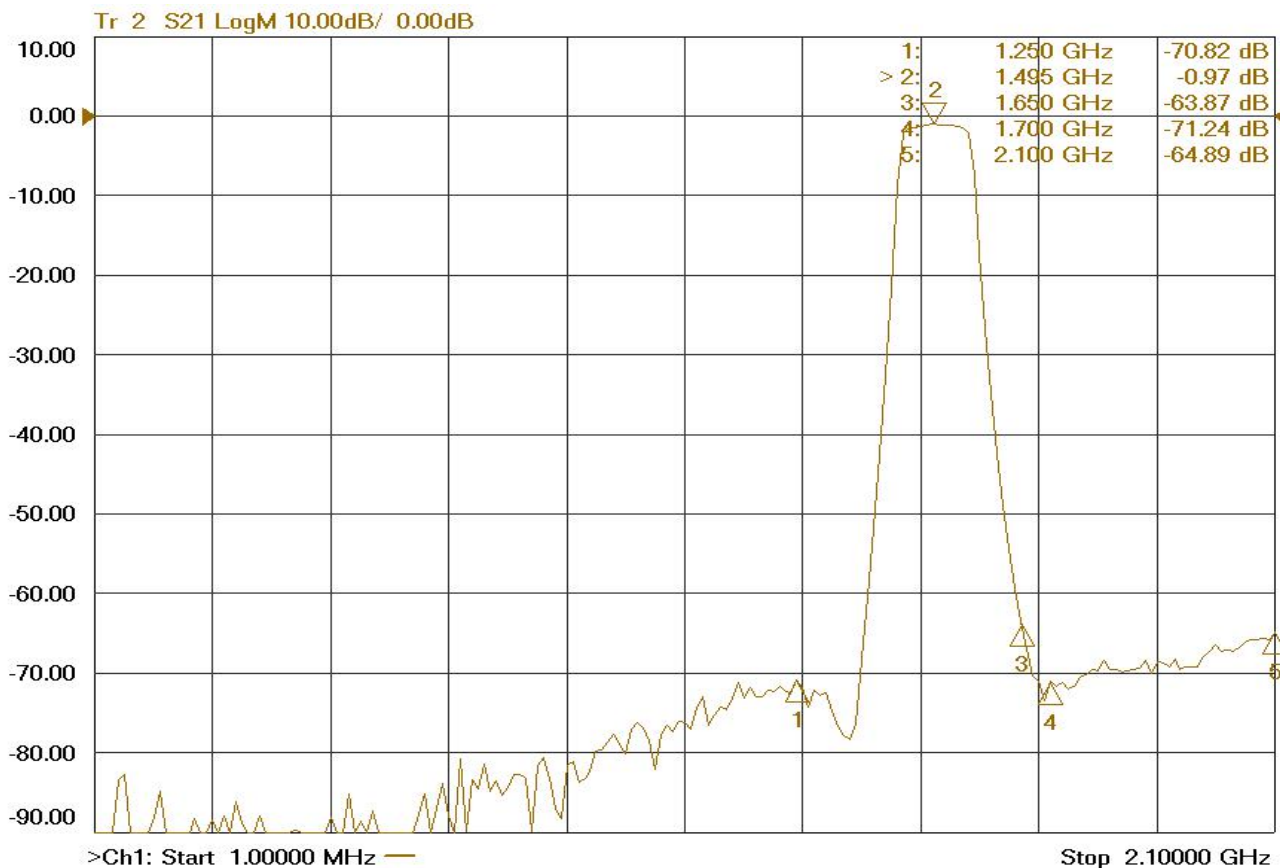
-55℃带内指标典型曲线



+85℃带内指标典型曲线

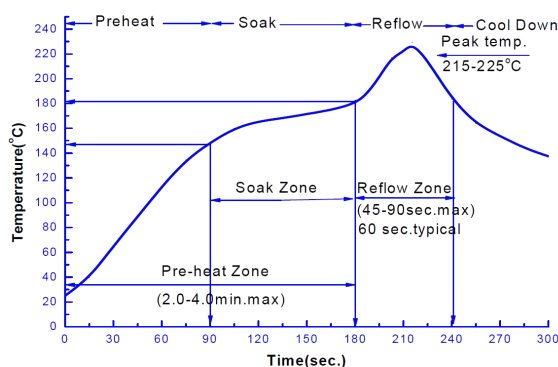


带外抑制典型曲线



产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，推荐采用采用组份 $\geq 2\%$ 的含银焊膏回流焊接，回流温度推荐曲线：



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
7. 其他使用注意事项参考成都宇熙《微波介质陶瓷滤波器产品使用说明》。